

第41期 中間報告書

2018年4月1日から2018年9月30日まで

京都発 → 世界へ

株主の皆さまへ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに、当社第41期中間報告書（2018年4月1日から2018年9月30日まで）をお届けし、事業の概況等についてご報告申し上げます。

当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、好調な企業収益を背景に緩やかな回復基調が続きました。世界経済は、引き続き堅調な米国経済をはじめ、欧州やアジア地域でも景気に明るさが見られるものの、米国と中国の貿易戦争による悪影響の懸念が高まっております。先行き不透明な状況が続いております。

半導体業界におきましては、昨年度まで高水準で推移していたメモリー需要が踊り場を迎え、メモリーメーカーの設備投資が停滞しております。また、仮想通貨向けの半導体需要が急減したことにより、大手ファブドリーでは売上予想を下方修正するなど、足元の状況には一時的な減速感が現れています。一方、IoT（モノのインターネット）の基盤となる5G（第5世代インターネット通信）の商用化に向け、5G対応半導体の開発の加速や、大規模な導入実験が行われております。また、電気自動車の普及や自動運転技術の長期化に向け、車載用半導体の搭載数の増加や高機能化により、実用的には半導体需要の拡大が見込まれるものと考えております。

このような状況のもと、当社グループは、半導体製造装置事業の裾野拡大のため、シンガポールのEMS企業であるKINERGY社の子会社から金型製造事業の譲受と、その受け皿となる子会社の設立を決定いたしました。さらに、同事業拡大のため、中国南通市政府と投資契約を締結し、めっき処理を含めた金型の一貫生産が可能な事業用地を取得いたしました。また、新規事業の拡大と既存事業の拡張のため、レーザー複合装置の草分け的存在であるオムロンレーザーフロント株式会社の全株式を取得し連結子会社化を行う等、「TOWA10年ビジョン」の達成に向け積極的な事業展開を行いました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高152億98百万円（前年同期比3億7百万円、2.0%減）、営業利益8億73百万円（前年同期比16億18百万円、64.9%減）、経常利益9億54百万円（前年同期比15億17百万円、61.4%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益8億81百万円（前年同期比7億75百万円、46.8%減）となりました。なお、中間配当は見送りとさせていただきますが、期末配当につきましては1株当たり16円を予定しております。

引き続き株主の皆さまのご期待にお応えいたすべく、今後も「ものづくり企業の真価に挑む」を合言葉に、企業価値の増大を図ってまいりますので、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2018年12月



代表取締役社長

岡田博和

連結財務諸表

● 四半期連結貸借対照表 (要旨)

(単位: 百万円)

科 目	当第2四半期末 2018年9月30日現在	前期末 2018年3月31日現在
【 資 産 の 部 】		
流 動 資 産	25,512	23,057
現金および預金	5,506	6,182
受取手形および売掛金	10,121	8,014
電子記録債権	212	151
たな卸資産	8,902	7,889
その他の資産	771	821
固 定 資 産	16,995	16,784
有形固定資産	11,778	11,580
建物および構築物	4,075	4,249
土地	4,378	4,371
その他の	3,325	2,960
無形固定資産	603	654
投資その他の資産	4,614	4,550
資産合計	42,508	39,842
【負債および純資産の部】		
流 動 負 債	13,143	10,871
支払手形および買掛金	2,419	3,943
電子記録債務	1,942	542
短期借入金	5,450	1,800
一年以内返済予定長期借入金	652	818
その他の	2,680	3,768
固 定 負 債	1,372	1,066
長期借入金	714	806
その他の	658	260
負債合計	14,516	11,937
株 主 資 本	26,103	25,622
資本金	8,932	8,932
資本剰余金	462	462
利益剰余金	16,720	16,238
自己株式	△ 11	△ 11
その他の包括利益累計額	1,888	2,282
純資産合計	27,992	27,905
負債・純資産合計	42,508	39,842

(注) 「[税効果会計に係る会計基準]の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、「四半期連結貸借対照表(要旨)」の「前期末(2018年3月31日現在)」については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値を記載しております。

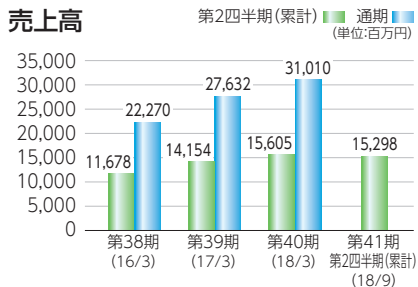
● 四半期連結損益計算書 (要旨)

(単位: 百万円)

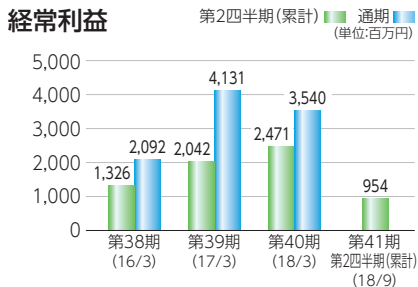
科 目	当第2四半期(累計) 2018年4月1日から 2018年9月30日まで	前第2四半期(累計) 2017年4月1日から 2017年9月30日まで
売 上 高	15,298	15,605
売 上 原 価	11,474	10,087
売 上 総 利 益	3,823	5,518
販売費および一般管理費	2,950	3,026
営 業 利 益	873	2,491
営 業 外 収 益	116	98
営 業 外 費 用	35	118
経 常 利 益	954	2,471
特 別 利 益	13	1
特 別 損 失	7	9
税金等調整前四半期純利益	959	2,463
法 人 税 等	77	791
四 半 期 純 利 益	881	1,671
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	14
親会社株主に帰属する四半期純利益	881	1,657

連結財務ハイライト

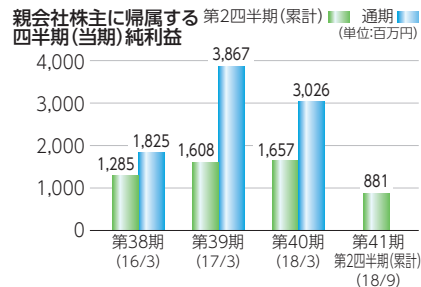
売上高



経常利益



親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益



TOWAレーザーフロント(株)が発足

8月にオムロン(株)の子会社であった同社(旧社名:オムロンレーザーフロント(株))の株式を取得し、同社はTOWAグループの一員として新たにスタートいたしました。同社の持つ高いレーザー関連技術と当社の持つ半導体製造の後工程技術を融合させ、コア技術を応用した新市場の開拓に取り組んでまいります。

中国で金型製造事業譲り受け

9月にシンガポールKINERGYグループの精技電子(南通)有限公司(中国江蘇省)より金型製造事業を譲り受けることを決議いたしました。併せてその受け皿となる新会社の設立も決議いたしました。新会社では、焼き入れ、めっき処理を含む金型、精密加工品等の生産を行います。当社は、中国において既に半導体製造装置の生産拠点を有しており、今後、金型製造事業との連携による更なる事業発展・拡大を目指してまいります。

TOWAM新工場建設開始

8月にマレーシアにある生産子会社のTOWAMにおきまして、新工場の建設がスタートいたしました。竣工は2019年8月の予定です。新工場では、生産量増加への対応および今後の需要拡大が見込まれる大判化対応装置(CPM1180)の生産やTSS(トータル・ソリューション・サービス)事業における部品製作専用ラインの設置の他、装置改造ビジネスなどの事業展開を視野に入れた工場構築を進めてまいります。なお、新工場の生産能力は、現在のTOWAMの生産能力の3倍を計画しております。

【新工場完成予想図】



会社の概要 (2018年9月30日現在)

商号	TOWA株式会社 (英文名 TOWA CORPORATION)
設立	1979年4月17日
資本金	8,932,627,777円
本社所在地	京都市南区上烏羽上調子町5番地 ☎ (075) 692-0250 (代表)
従業員数	519名
ホームページ	http://www.towajapan.co.jp
上場取引所	東京証券取引所市場第一部

役員	代表取締役社長 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員	岡浦田石小桑和蒲伊高早鈕韓	田上村田林木氣生喜代藤瀬坂	博吉耕久大輔重篤二昇舜相	和浩住一芳肇輔重篤二昇舜倫
----	--	---------------	---------------	--------------	---------------

株式の状況 (2018年9月30日現在)

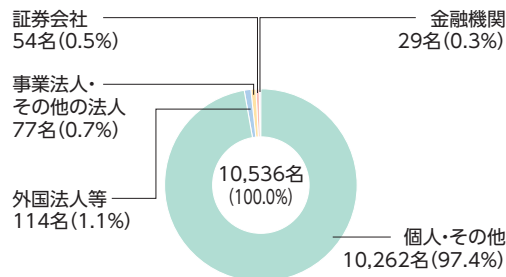
- 発行可能株式総数 80,000,000株
- 発行済株式の総数 25,021,832株
- 株主数 10,536名
- 大株主

株主名	持株数	持株比率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	5,637 千株	22.54 %
株式会社 ケイビー恒産	2,000	8.00
蒲生 徳子	1,318	5.27
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE HCR00	1,054	4.22
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS	1,020	4.08
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	968	3.87
株式会社 京都銀行	699	2.80
坂東 幸子	510	2.04
CHASE MANHATTAN BANK GTSCIENTS ACCOUNT ESCROW	357	1.43
京都中央信用金庫	325	1.30

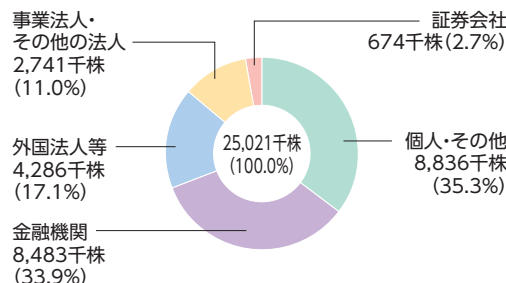
(注1) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は信託業務に係るものです。

(注2) 持株比率は、自己株式(12,362株)を控除して計算しております。

所有者別株主数分布



所有者別株式数分布



TOWAグループ (2018年9月30日現在)

国内

TOWA株式会社
 本社・工場 京都東事業所
 坂東記念研究所 九州事業所
 東京営業所
 株式会社バンディック
 TOWATEC株式会社
 TOWAレーザーフロント株式会社

海外

TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd. (シンガポール)
 TOWAM Sdn. Bhd. (マレーシア)
 TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp. (フィリピン)
 TOWA USA Corporation (米国)
 TOWA Europe B.V. (オランダ)
 TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 (中国)

東和半導体設備(上海)有限公司 (中国)
 上海沙迪克軟件有限公司 (中国)
 蘇州STK鑄造有限公司 (中国)
 台湾東和半導体設備股份有限公司 (台湾)
 TOWA韓国株式会社 (韓国)

株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年
 定時株主総会 毎年6月
 基準日 株主総会権利行使および期末配当 3月31日
 中間配当 9月30日
 単元株式数 100株
 株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
 みずほ信託銀行株式会社
 同事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

郵便物の郵送先及び電話お問合せ先 〒168-8507東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 みずほ信託銀行株式会社証券代行部
 ☎0120-288-324 (フリーダイヤル)
 未払配当金のお支払 みずほ信託銀行本店および全国各支店
 みずほ銀行本店および全国各支店
 (みずほ証券では取次のみとなります。)
 公告方法 電子公告の方法により行います。但し、やむをえない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。
 公告掲載URL <http://www.towajapan.co.jp>